

Simply Insert



- Low-stress reactive joining of a silicon wafer provided with an optical coating on porous or honeycomb-shaped metal carriers using solder, e. g. laser scanning mirror
- Point- and line-shaped joints can be realized

MULTI-MATERIAL JOINTS

- Reactive joining of temperature sensitive materials and those with different thermal expansion coefficients
- Examples: Silicon ceramics, glass-metal and carbide steel, diamond metal, etc.



LASER PROCESSING

- Hermetically sealed and tight joints of chips and sensors
- Electrical and thermal contacting of sensors and power electronics
- Bonding of silicon wafers to various substrates



MICROSYSTEMS TECHNOLOGY

- Automated reactive joining of elastomer-based door rubber seals
- Tightly bonded within three seconds
- High mechanical strength and lifetime under alternating climatic load



AUTOMOTIVE INDUSTRY

- Gentle reactive joining of fiber-reinforced and non-reinforced plastics in fractions of a second
- Solid plastic-metal hybrid joints can be realized



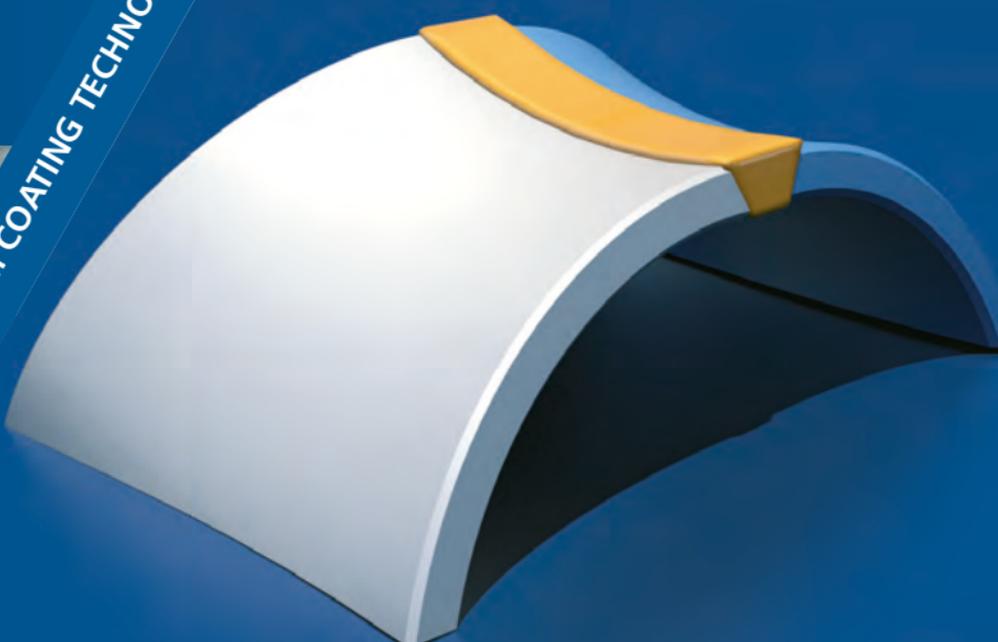
LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION

- Bonding of sputtering targets, e. g. silver based targets on copper, using solder for vacuum coating
- Planar joint within a few seconds
- Long-term stable and highly conductive connections



VACUUM COATING TECHNOLOGY

Comparable: Applications of Reactive Joining



Fraunhofer Institute for
Material and Beam Technology IWS

Winterbergstraße 28
DE-01277 Dresden

rms@iws.fraunhofer.de
www.iws.fraunhofer.de/rms





MULTI-MATERIAL-VERBINDUNGEN

- Spannungsarmes reaktives Fügen eines mit einer optischen Beschichtung versehenen Siliziumwafers auf poröse oder wabenförmige Metallträger unter Nutzung von Lot, z. B. Laserscanner-spiegel
- Punkt- und linienförmige Verbindungen realisierbar



LASERBEARBEITUNG

- Reaktives Fügen temperaturempfindlicher Materialien und solcher mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
- Beispiele: Silizium-Keramik, Glas-Metall und Hartmetall-Stahl, Diamant-Metall, etc.



MIKROSYSTEMTECHNIK

- Hermetisch dichte und feste Verbindungen von Chips und Sensoren
- Elektrische und thermische Kontaktierung von Sensoren und Leistungselektronik
- Bonden von Siliziumwafern auf verschiedenste Substrate

- Automatisierbares reaktives Fügen von Elastomer-basierten Türgummi-dichtungen
- Stoffschlüssige Verbindung innerhalb von drei Sekunden
- Hohe mechanische Festigkeit und Lebensdauer bei klimatischer Wechsellast



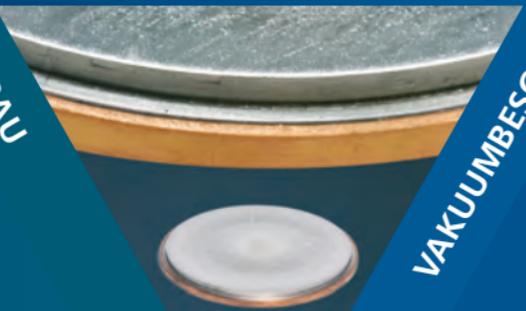
AUTOMOTIVE

- Schonendes reaktives Fügen von faserverstärkten und -unverstärkten Kunststoffen in Sekundenbruchteilen
- Feste Kunststoff-Metall-Hybridverbindungen realisierbar



LEICHTBAU

- Reaktives Fügen von unterschiedlichen Materialien, z. B. Bonden von Sputter-targets mit Silber auf Kupfer, unter Nutzung von Lot für Vakuumbeschichtungen
- Flächenförmige Verbindung innerhalb weniger Sekunden
- Langzeitstabile und hochleitfähige Verbindungen



VAKUUMBESCHICHTUNGSTECHNIK

Einfach unzertrennlich: Anwendungen des reaktiven Fügens

